

OPC UA : Une norme sécurisée d'interopérabilité industrielle



Jour 1

CONCEPTS DE BASE D'OPC UA L'Information modeling

- › Présentation de la Fondation OPC et de l'OPC UA
- › Concepts d'address space dans OPC UA
- › Modèle d'objet OPC UA : notions de nœuds et de références
- › Métamodèle OPC UA et les classes de nœuds
- › Les références dans OPC UA
- › Concepts de Data Typing dans OPC UA
- › Approche de modélisation de l'information
- › Pratique : définir un modèle d'information personnalisé
- › Les services dans OPC UA (lecture, écriture, requête, etc.)
- › Machines d'état OPC UA

Jour 2

CONCEPTS AVANCÉS D'OPC UA Sémantique et comportement

- › Accès aux données dans OPC UA
- › Événements dans OPC UA
- › Alarmes et conditions dans OPC UA
- › Références des dictionnaires pour l'interopérabilité
- › Conformité pour l'interopérabilité : profils et unités de conformité
- › Les companion specifications dans OPC UA
- › Pratique : conformité aux companion specifications
- › Pratique : développement d'un simple serveur OPC UA
- › Pratique : connexion du serveur OPC UA aux clients OPC UA génériques
- › Avantages de l'adhésion à la Fondation OPC



Agileo Automation est adhérent Numeum, membre d'OPC Foundation et d'OPC Hub France.
Formateur référencé expert OPC UA
[Scannez le QR CODE pour voir la liste].



Agileo Automation participe activement à des groupes de travail au sein d'OPC Foundation tels que le « Core working Group » et plusieurs groupes de travail concernant la rédaction de *Companion Specifications*.

Articles de recherche parus sur OPC UA dans le cadre des travaux de recherche d'Agileo Automation :

Golra, F. R., & Engel, M. (2021, September). An industrial feedback on the use of OPC UA for the vertical integration of semiconductor front-ends. In 2021 26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9613384>

Golra, F. R., Azaiez, S., & Engel, M. (2020, June). Multi-level modeling to OPC UA for migrating to Industry 4.0 in semiconductor manufacturing. In 2020 IEEE Conference on Industrial Cyberphysical Systems, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9274791>